

**关键指标**

- 频率: 0.8~2.5GHz
- 增益: 36dB
- 噪声系数: 0.5dB
- 1dB 压缩点输出功率: 18.5dBm
- 电压/电流: +5V/58mA
- 芯片尺寸: 12.7mm×8.89mm

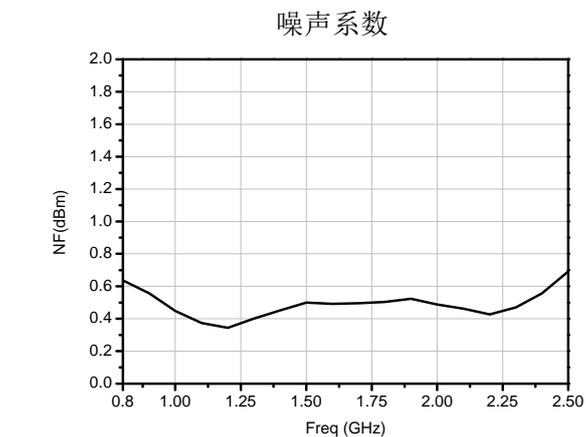
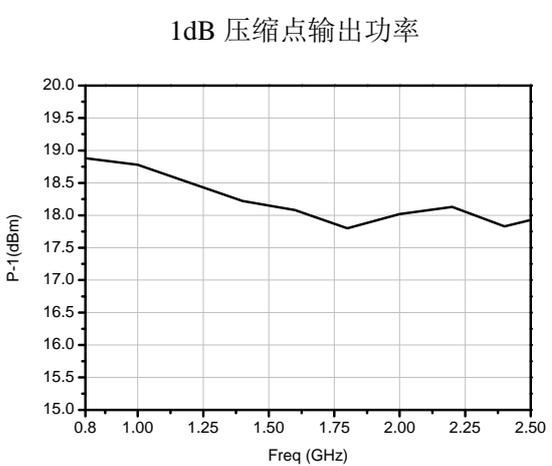
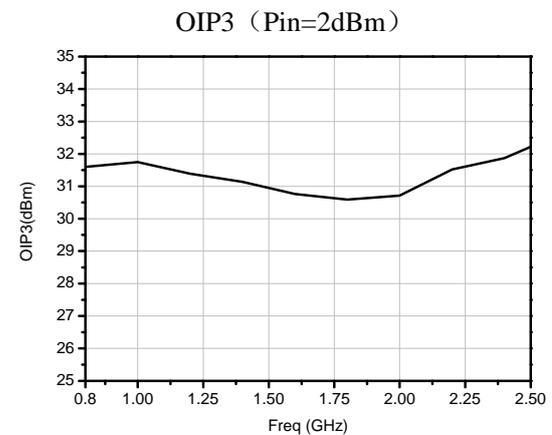
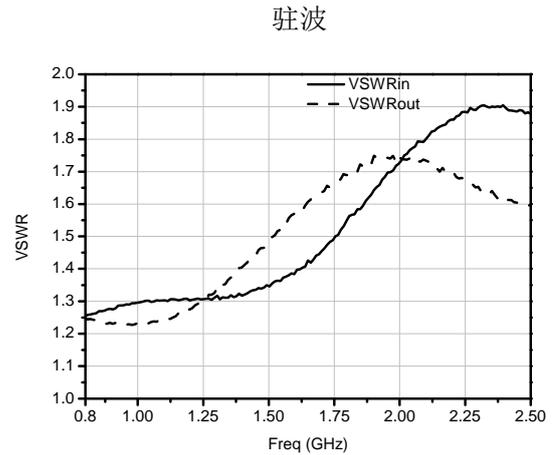
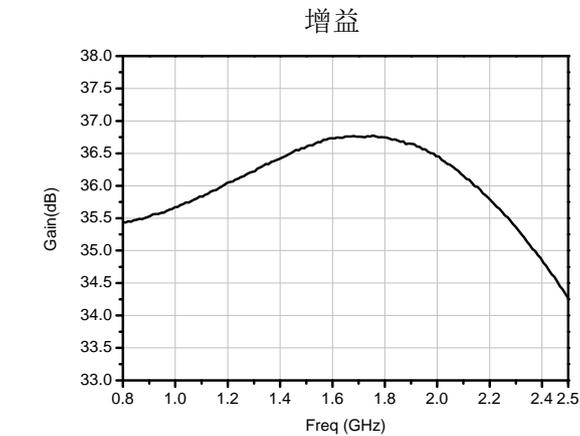
**产品简介**

HG112F7-Q09 是一款 0.8~2.5GHz 低噪声放大器封装芯片, 增益为 36dB, 噪声系数 0.5dB, 1dB 压缩点输出功率为 18.5dBm。

**电性能 (TA=25°C, Vd=+5V)**

| 指标               | 最小值     | 典型值  | 最大值 |
|------------------|---------|------|-----|
| 频率(GHz)          | 0.8~2.5 |      |     |
| 增益(dB)           | —       | 36   | —   |
| 增益平坦度(dB)        | —       | ±1.3 | —   |
| 输入驻波             | —       | 1.5  | —   |
| 输出驻波             | —       | 1.4  | —   |
| 噪声系数(dB)         | —       | 0.5  | —   |
| 1dB 压缩点输出功率(dBm) | —       | 18.5 | —   |

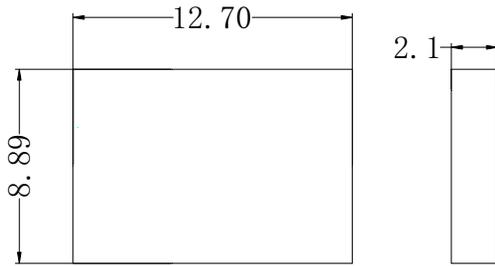
**典型测试曲线**



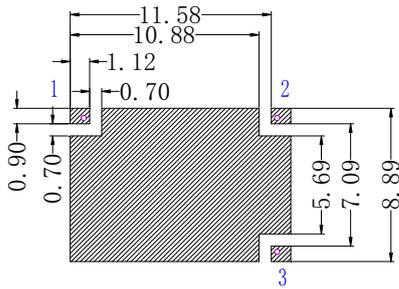
**绝对额定最大值**

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作电压   | +7V         |
| 最大输入功率 | +18dBm      |
| 工作温度   | -55°C~125°C |
| 存储温度   | -65°C~150°C |

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



端口说明

| 端口号 | 端口说明  |
|-----|-------|
| 1   | RFin  |
| 2   | RFout |
| 3   | Vdd   |

注意事项

1. 产品在干燥环境中储存和使用，并注意防静电；
2. 产品用导电胶或铅锡烧结（合金温度不能超过 220°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；